

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載
【部門区分】第 7 部門第 2 区分
【発行日】令和 5 年 3 月 9 日(2023.3.9)

【公開番号】特開 2022-181820(P2022-181820A)
【公開日】令和 4 年 12 月 8 日(2022.12.8)
【年通号数】公開公報(特許)2022-226
【出願番号】特願 2021-88991(P2021-88991)
【国際特許分類】

H 0 1 L 23/12(2006.01)

10

H 0 1 L 25/07(2006.01)

【F I】

H 0 1 L 23/12 Q

H 0 1 L 23/12 H

H 0 1 L 25/04 C

【手続補正書】

【提出日】令和 5 年 3 月 1 日(2023.3.1)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

20

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

上下アーム回路(9)を構成する半導体装置であって、
両面に主電極(40D、40S)を有する半導体素子(40)と、
絶縁基材(51、61)と、前記絶縁基材の表面に配置され、前記主電極と電氣的に接
続された表面金属体(52、62)と、前記絶縁基材の裏面に配置された裏面金属体(5
3、63)と、を有する基板(50、60)と、を備え、
前記表面金属体は、所定方向に延設された第 1 配線(64)と、前記第 1 配線とは電位
が異なり、前記第 1 配線との間に所定の間隔を有して前記所定方向に延設された第 2 配線
(65)と、を有し、
前記第 1 配線と前記第 2 配線とは、前記所定方向に沿って流れる電流が互いに逆向きであ
り、

30

前記第 1 配線と前記第 2 配線との間隔が、前記表面金属体の厚み以下である、半導体装
置。

【手続補正 2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0006

40

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0006】

ここに開示された半導体装置は、
上下アーム回路(9)を構成する半導体装置であって、
両面に主電極(40D、40S)を有する半導体素子(40)と、
絶縁基材(51、61)と、絶縁基材の表面に配置され、主電極と電氣的に接続された
表面金属体(52、62)と、絶縁基材の裏面に配置された裏面金属体(53、63)と
、を有する基板(50、60)と、を備え、
表面金属体は、所定方向に延設された第 1 配線(64)と、第 1 配線とは電位が異なり

50

、第 1 配線との間に所定の間隔を有して所定方向に延設された第 2 配線（ 6 5 ）と、を有し、
第 1 配線と第 2 配線とは、所定方向に沿って流れる電流が互いに逆向きであり、
第 1 配線と第 2 配線との間隔が、表面金属体の厚み以下である。

10

20

30

40

50